



产 品 承 认 书

产品名称: 0805-T0.8 红外850nm 发射二极管

产品型号: XL-2012HIRC-850

客户名称: _____

客户料号: _____

承认日期: _____

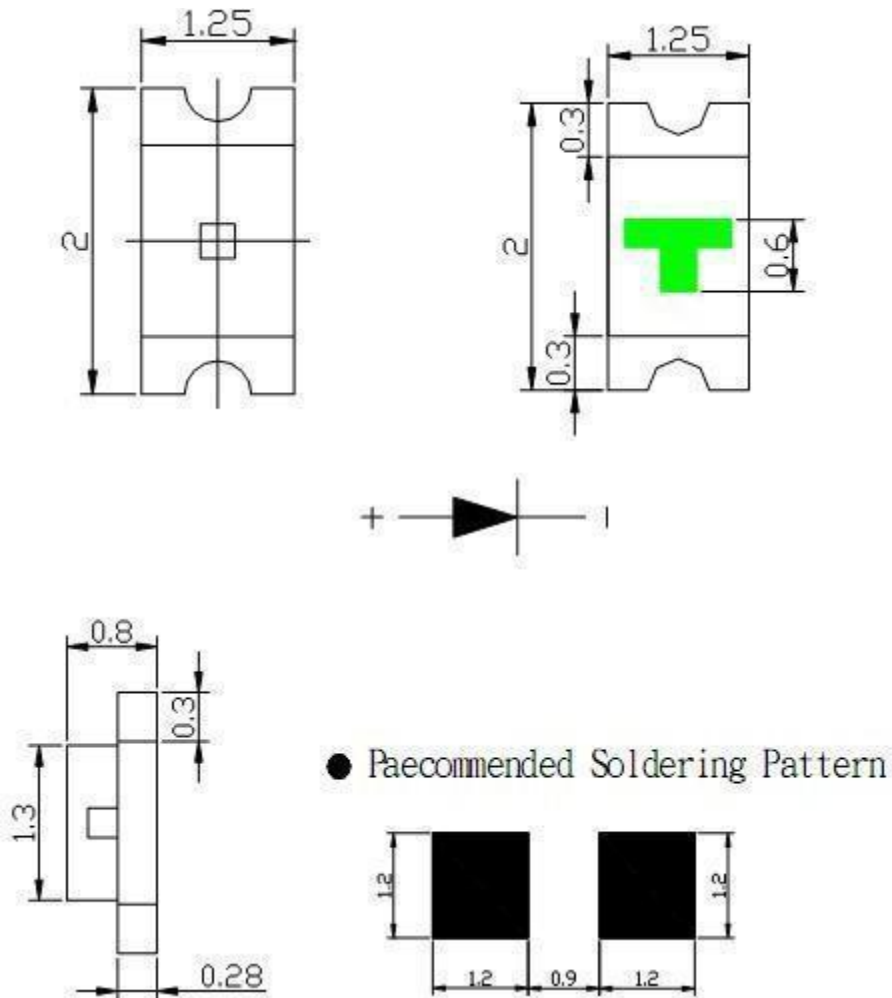
深圳市成兴光电子科技有限公司		
制定	审核	核准

客户承认栏		
确认	审核	核准

一、产品描述:

- 外观尺寸(L/W/H) : 2.0 × 1.2 × 0.75 mm
- 颜色 : 红外发射850nm
- 胶体: 透明胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

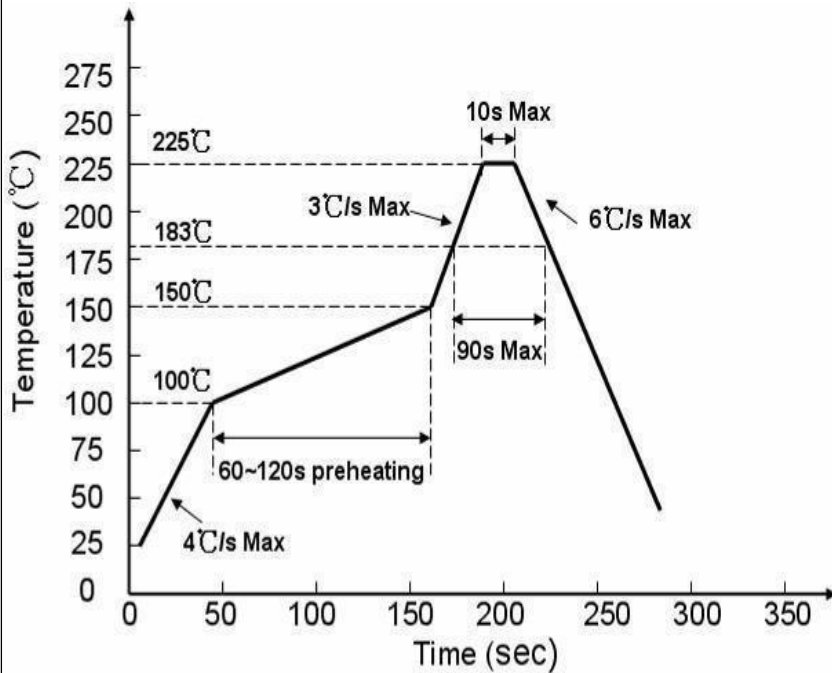
二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:



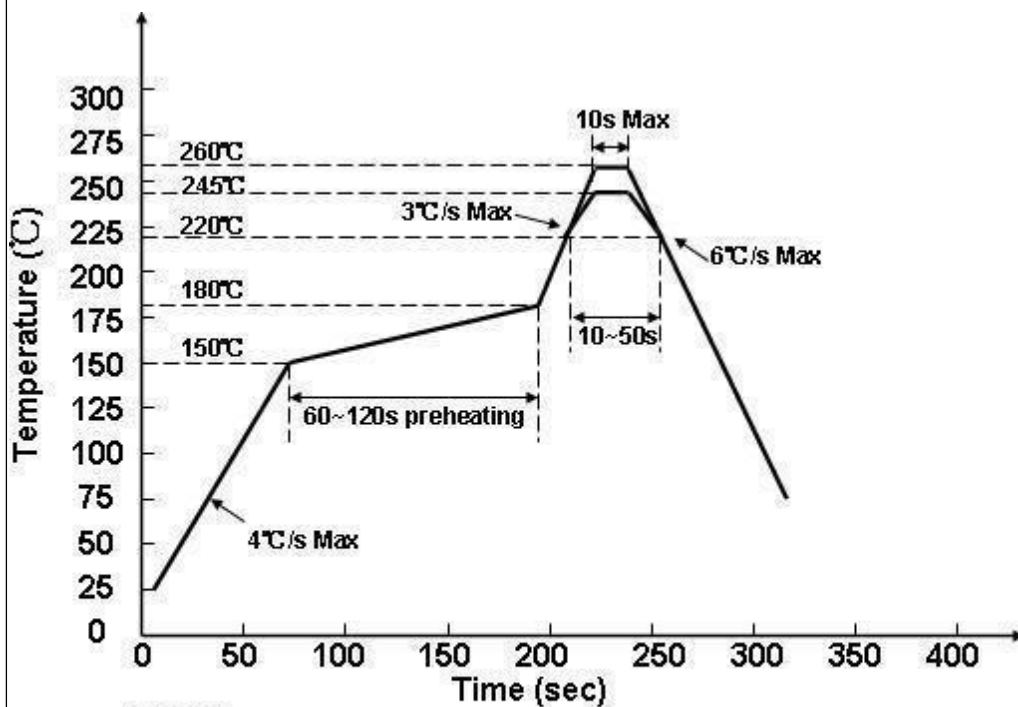
- 备注: 1. 单位 : 毫米 (mm)
 2. 公差 : 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

三、建议焊接温度曲线

3.1、有铅制程



3.2、无铅制程



Notes:

We recommend the soldering temperature $245 \pm 5^{\circ}\text{C}$;

The maximum temperature should be limited to 260°C .



产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	3 of 10
---------	-----	-------------	------------	------	---------

四、 最大绝对额定值 (Ta=25°C):

参 数	符 号	最大额定值	单 位
消耗功率	Pd	70	mW
最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	I _{FP}	70	mA
正向直流工作电流	I _F	30	mA
反向电压	V _R	5	V
工作环境温度	Topr	-30°C ~ +85°C	
存储环境温度	Tstg	-40°C ~ +90°C	
焊接条件	Tsol	回流焊 : 260°C , 5s 手动焊 : 300°C , 3s	



产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	4 of 10
---------	-----	-------------	------------	------	---------

五、光电参数 (Ta=25°C):

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	2	----	5	mcd	IF = 20mA
半光强视角	2 θ 1/2	---	120	---	deg	IF = 20mA
波长	λ d	850	---	858	nm	IF=20mA
正向电压	VF	1.3	---	1.7	V	IF=20mA
反向电流	IR	---	---	10	uA	VR=5V

亮度分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
G01	2	3	mcd	IF=20mA
G02	3	4		
G03	4	5		

电压分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
F0	1.3	1.5	V	IF=20mA
F1	1.5	1.7		

波长分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
HR0	850	855	nm	IF=20mA
HR1	850	852		
HR4	856	858		

六、 光电参数代表值特征曲线:

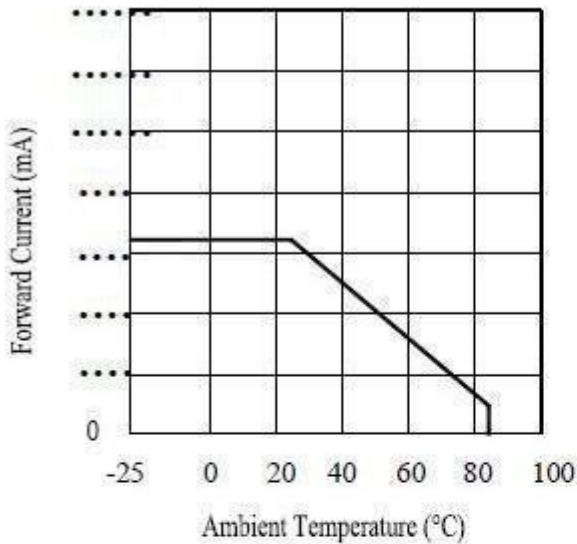


Fig.3 Forward Current vs. Forward Voltage

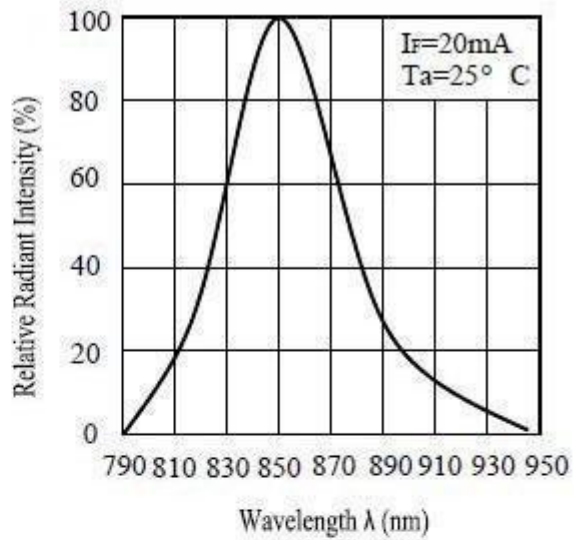
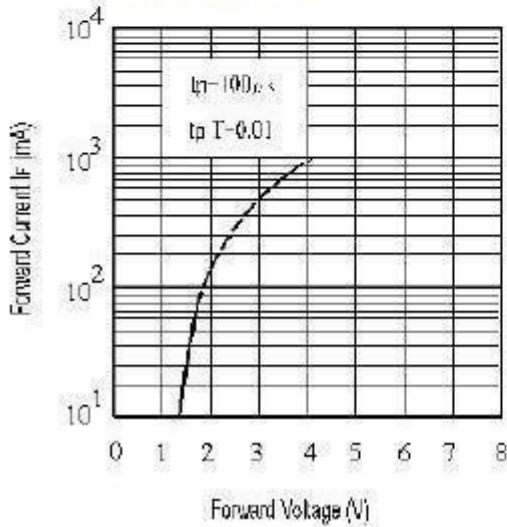
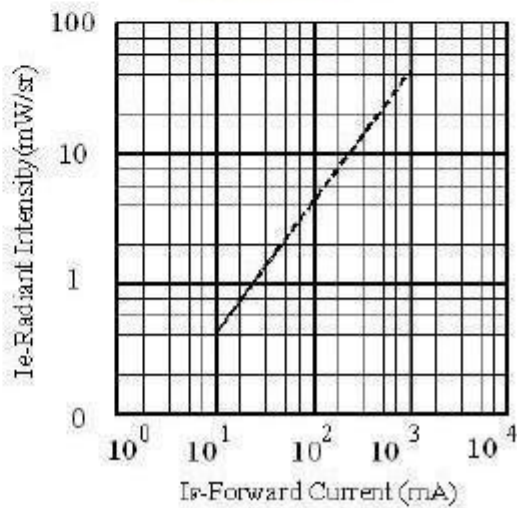


Fig.4 Relative Intensity vs. Forward Current





产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	6 of 10
---------	-----	-------------	------------	------	---------

七、标签标识:

CAT: 光强 (mcd)

HUE: XY

REF: 电压 (V)

误差范围

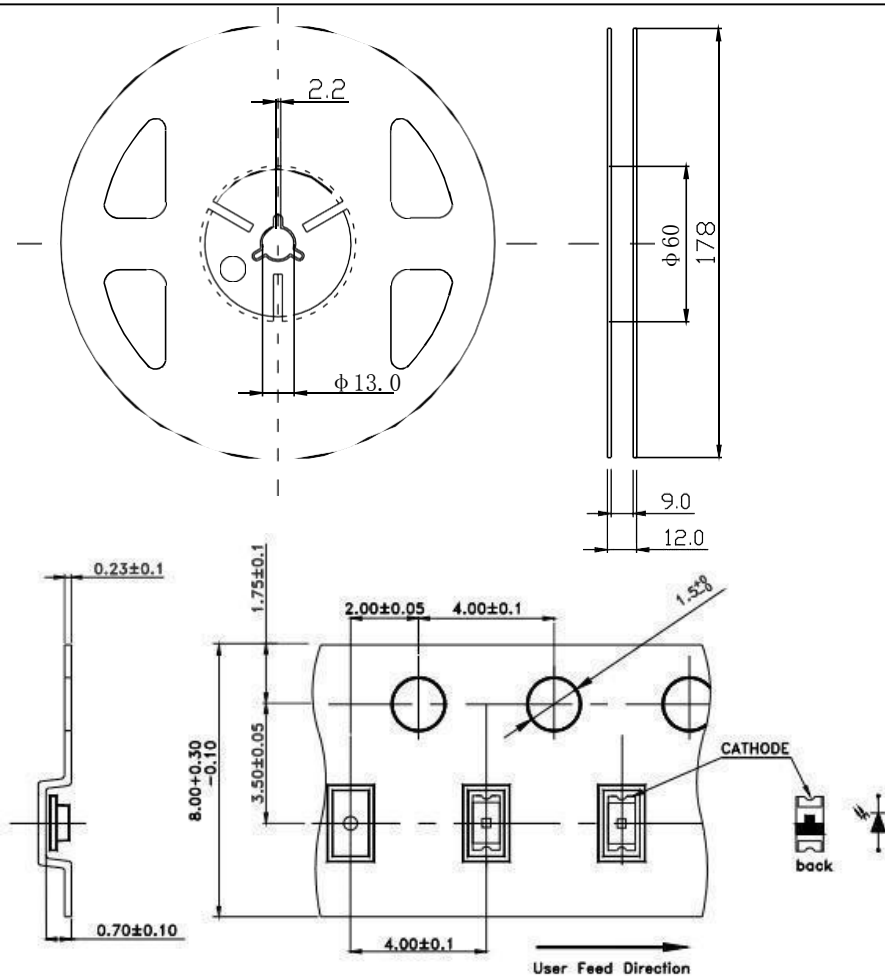
a. Luminous Intensity: $\pm 15\%$

b. HUE: ± 0.003

c. Forward Voltage: $\pm 0.1V$

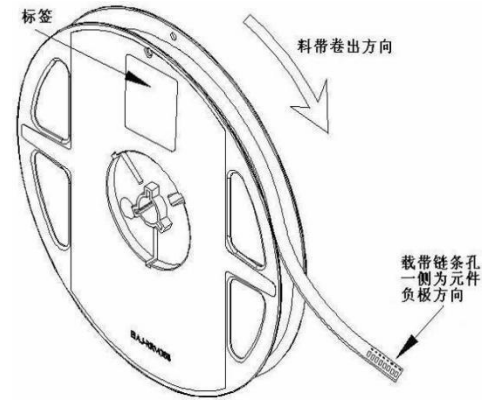
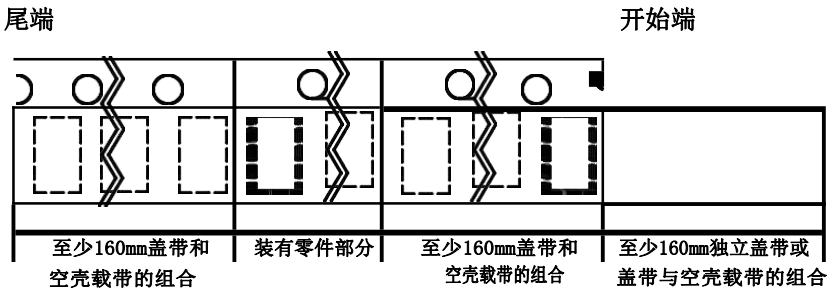


八、包装载带与圆盘尺寸:

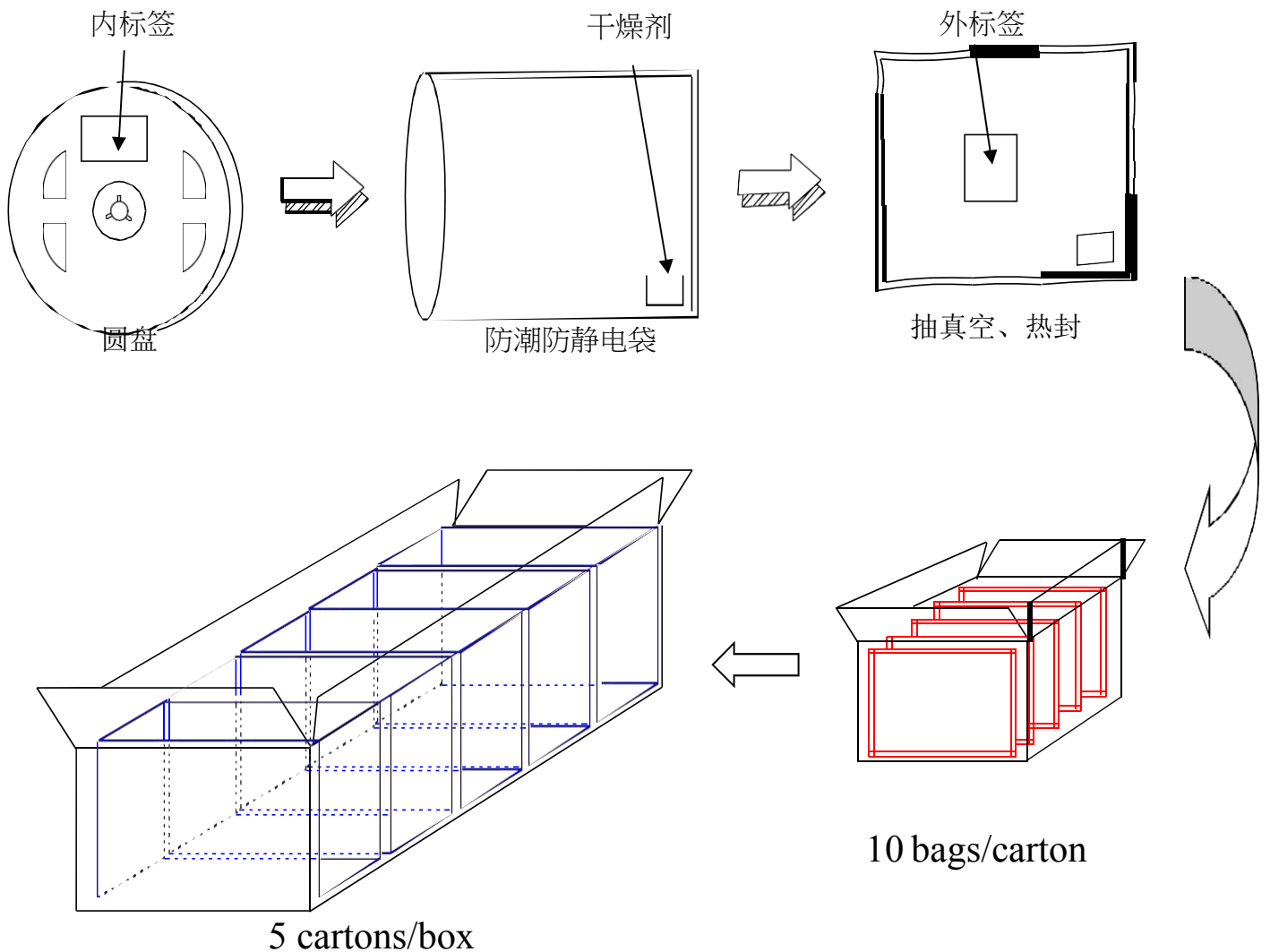


备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm);
2. 尺寸公差如无标注, 为 $\pm 0.15\text{mm}$;

九、圆盘及载带卷出方向及空穴规格：



十、内包装及外包装：





产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	8 of 10
---------	-----	-------------	------------	------	---------

十一、信赖性实验：

测试项目	测试条件	测试次数	参考标准	失效判定标准	失效 LED 数量 (PCS)
防潮等级	1.回流焊最高温度=260℃,10秒,2次回 流焊; 2.回流焊之前存储条件:30℃,相对湿度 =70%,168H;	-	JEITA ED-4701 300.301	# 1	0/22
焊接信赖性 (无铅回流 焊)	回流焊最高温度=245±5℃,5秒(无铅 回流焊)	-	JEITA ED-4701 303 303A	# 2	0/22
冷热循环	-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟	300个 循环	JESD22-A104	# 1	0/22
冷热冲击	-35℃ 15分钟 转换时间3分钟 85℃ 15分钟	300个 循环	JESD22-A106	# 1	0/22
高温存储	Ta=100℃	1000小时	JESD22-A103	# 1	0/22
低温存储	Ta=-40℃	1000小时	JESD22-A119	# 1	0/22
常温老化	Ta=25℃ IF=20mA	1000小时	JESD22-A108	# 1	0/22

(2) 失效标准

标准 #	项目	测试条件	失效标准
# 1	正向电压(V _F)	I _F =20mA	>U.S.L*1.1
	光强 (IV)	I _F =20mA	<L.S.L*0.7
	反向电流(I _R)	V _R =5V	>U.S.L*2.0
# 2	焊接可靠性	/	锡膏覆盖焊盘比例小于 95%

★ U. S. L : 规格上限 L. S. L : 规格下限



产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	9 of 10
---------	-----	-------------	------------	------	---------

十二、使用注意事项:

◆ 使用:

1. 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为使 LED 有较好的性能表现, 应将 LED 远离热源。

2. 光电参数公差:

正向电压(REF / VF): $\pm 0.1V$

亮度(CAT / IV): $\pm 15\%$

色坐标(HUE / XY): ± 0.003

◆ 存储:

1. 未打开原始包装的情况下, 建议储存的环境为: 温度 $5^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$, 湿度 85%RH 以下。当库存超过两个月, 使用前应做除湿处理, 条件 $60^{\circ}C/8$ 小时;

2. 打开原始包装后, 建议储存环境为: 温度 $5 \sim 30^{\circ}C$, 湿度 60% 以下;

3. LED 是湿度敏感元件, 为避免元件吸湿, 建议打开包装后, 将其储存在有干燥剂的密闭容器内, 或者储存在氮气防潮柜内;

4. 打开包装后, 元件应该在 168 小时 (7 天) 内使用; 且贴片后应尽快完成焊接;

5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时 (7 天), 应做除湿处理;

烘烤条件: $60^{\circ}C/24$ 小时。

◆ ESD 静电防护

LED (特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED) 是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常, 比如漏电流过大, VF 变低, 或者无法点亮等等。所以请注意以下事项:

1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套;

2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等, 应该做适当的接地保护 (接地阻抗值 10Ω 以内);

3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱, 严禁使用普通塑料制品;

4. 建议在作业过程中, 使用离子风扇来抑制静电的产生;

5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。



产 品 承 认 书

Part No. : XL-2012HIRC-850

Version

A.2

Issued date

2019.01.01

Page

10 of 10

◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

◆ 焊接

1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
2. 回流焊焊接次数不得超过两次；
3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。
烙铁最大功率应不超过 30W；
4. 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；
5. 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

◆ 其他

- 1 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 2 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。